

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**成都莱普科技股份有限公司**

**首次公开发行股票并在科创板上市**

**之**

**上市保荐书**

**保荐人**



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

**二〇二五年九月**

## 保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志伟、陈忱根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 释 义.....                                                          | 3  |
| 一、发行人基本情况 .....                                                   | 5  |
| 二、发行人本次发行情况 .....                                                 | 13 |
| 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式 .....               | 16 |
| 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .....                                | 19 |
| 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 .....                                          | 19 |
| 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ..... | 20 |
| 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 .....  | 21 |
| 八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的上市条件的说明 .....    | 22 |
| 九、持续督导期间的工作安排 .....                                               | 27 |
| 十、保荐人关于本项目的推荐结论 .....                                             | 27 |

## 释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

### 一、普通术语

|                 |   |                                                   |
|-----------------|---|---------------------------------------------------|
| 中信建投证券、保荐人、主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 发行人、公司、本公司、莱普科技 | 指 | 成都莱普科技股份有限公司                                      |
| 莱普有限            | 指 | 成都莱普科技有限公司，发行人前身                                  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                           |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                      |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                      |
| 上市保荐书、本上市保荐书    | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》 |

### 二、专业术语

|         |   |                                                                                                                         |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 激光      | 指 | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation（LASER），由粒子受激辐射产生的光束，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点，广泛应用于各种工业制造及科研领域。 |
| 激光器     | 指 | 产生、输出激光的器件，是激光加工系统的核心器件。                                                                                                |
| 光、机、电、算 | 指 | 光：采用先进光学设计，光束整形及光学监控系统，实现激光光束整形匀化，高精度调控，确保激光光学系统长期稳定可靠。                                                                 |
|         | 指 | 机：基于精密机械结构设计，确保设备具备高稳定性和高定位精度，支持灵活的模块化配置。                                                                               |
|         | 指 | 电：融合了高效率的电气控制系统，提供完善的电控解决方案和快速的信号处理能力。全方位的安全防护措施，进一步确保了设备和操作者的安全，提升了系统的可靠性和稳定性。                                         |
|         | 指 | 算：利用智能化计算平台，支持实时数据采集分析及监控维护，优化生产和维护流程。                                                                                  |
| 热处理     | 指 | 一类半导体制程步骤，涉及将半导体器件或材料在控制温度下暴露于热环境中，以改变其性能、结构或其他特性。主要涉及晶体生长与结晶改善、应力控制、掺杂和扩散、氧化与退火、金属连接的形成等工艺。                            |
| 激光热处理   | 指 | 一种利用激光束对材料进行局部加热和处理的技术，通常涉及使用高能激光束照射材料表面，以实现诸如热处理、改性、熔化、硬化等目的。                                                          |
| 退火      | 指 | 一种半导体制程步骤，是通过将半导体材料加热到特定温度，然后在控制的环境下冷却，以改善晶体结构、消除缺陷或改变材料的性质。                                                            |
| 激光退火    | 指 | 一种利用激光束对材料进行热处理的过程。通过控制激光束的功率和照射时间，可以实现对材料局部区域的加热和冷却，从而改变材料的结构和性质。                                                      |

在本上市保荐书除特别说明外，所有数值保留 2 位或 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人概况

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 成都莱普科技股份有限公司                                                                                                                                       |
| 注册地址      | 成都高新区康强三路 179 号                                                                                                                                    |
| 成立时间      | 2003 年 12 月 22 日                                                                                                                                   |
| 注册资本      | 4,818.00 万元人民币                                                                                                                                     |
| 法定代表人     | 叶向明                                                                                                                                                |
| 董事会秘书     | 唐昊                                                                                                                                                 |
| 联系电话      | 028-88556028                                                                                                                                       |
| 互联网网址     | <a href="http://www.la-ap.com">http://www.la-ap.com</a>                                                                                            |
| 主营业务      | 莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。 |
| 本次证券发行的类型 | 首次公开发行股票并在科创板上市                                                                                                                                    |

### （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

#### 1、发行人主营业务

莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。

先进精密激光技术贯穿应用于半导体制造及封装测试流程，具有低热预算、低应力、高精度、无接触、工艺时间灵活、工艺兼容性强等优势，可以精准选定工艺区域，是半导体 28nm 及以下制程、三维堆叠、同质集成、异构集成、Chiplets 等先进制程和先进封装的关键支撑技术之一。

莱普科技始终以用户需求为牵引，立足于自主创新，面向半导体产业有针对性地开展先进精密激光技术、创新工艺和设备的研发工作，并延伸布局至精密电子及 MLED 等产业。公司依托自身在光学、机械、电气、软件算法以及半导体创新工艺等领域的深耕积累和人才培育，已具备为客户批量化供应先进激光工艺

设备与解决方案的技术实力，成功赋能下游半导体制造工艺优化及先进产品开发，并助力我国存储芯片产业在全球竞争中形成局部领先地位。同时，公司积极为国产零部件供应商提供产业验证机会，推动上游突破技术瓶颈、加速技术迭代。

莱普科技现已适配国内半导体产业技术特征开发了多款原创性产品，并推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，打破国际厂商在国内市场长期垄断局面。报告期内，公司相关设备已部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线，并成功应用于先进制程存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。

莱普科技是国家高新技术企业和国家级“专精特新”重点小巨人企业，2024 年四川省重点“小巨人”企业，入选“2024 年成都市集成电路产业链链主企业”。自成立以来，公司已承担国家某部委应用专项攻关任务，建成了四川省企业技术中心、四川省先进全固态激光工程技术研究中心，并与中国科学院半导体研究所、合作单位 A、合作单位 B 就半导体新型工艺开发建立合作研发机制。公司荣获集成电路创新联盟第六届和第七届“IC 创新奖—产业链合作奖”，是本奖项设立以来唯一获奖的激光热处理设备供应商，也是唯一连续获得本奖项的半导体设备供应商；公司另获中国通信工业协会“2020 年度半导体设备卓越创新奖”、客户 A “2024 年度优秀技术支持团队”、客户 A “协同创新奖”、客户 C “新锐突破奖”、客户 C “研发合作奖”等奖项。

2、核心技术情况

发行人核心技术均来源于自主研发。公司拥有的核心技术具体情况如下：

| 序号 | 核心技术名称        | 专利及其他保护措施   | 技术水平 | 应用和贡献情况 |          |
|----|---------------|-------------|------|---------|----------|
|    |               |             |      | 激光热处理设备 | 专用激光加工设备 |
| 1  | 多波长固态激光技术     | 已获授权专利 6 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 2  | 多波长光路整形技术     | 已获授权专利 11 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 3  | 高精度能量密度控制技术   | 已获授权专利 5 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 4  | 复杂多变量协同监测检测技术 | 已获授权专利 7 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |

| 序号 | 核心技术名称          | 专利及其他保护措施   | 技术水平 | 应用和贡献情况 |          |
|----|-----------------|-------------|------|---------|----------|
|    |                 |             |      | 激光热处理设备 | 专用激光加工设备 |
| 5  | 半导体领域多用途激光加工技术  | 已获授权专利 46 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 6  | 半导体领域激光设备整机设计技术 | 已获授权专利 15 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |

### （1）多波长固态激光技术

多波长固态激光技术，是指针对半导体领域先进精密激光技术对激光波长、脉宽、重复频率、光束质量、光斑稳定性等参数的要求，在光学带宽调控技术、偏振调控技术、合束技术等底层技术方面开展工作，确认泵浦源、增益晶体、倍频晶体、三倍频晶体、谐振腔、声光或电光调制器等元件的最优参数范围，并集成为多波长固态激光技术体系，从而为半导体领域精密激光工艺及设备要求提供核心部件保障。

### （2）多波长光路整形技术

多波长光路整形技术，是指针对半导体领域先进精密激光技术需求，采用微透镜光学、衍射光学、非曲面光学及其组合等方式，对不同波长激光器出射的光束进行扩束、准直、相位调控、强度调控、波前调控、合束或分束、聚焦、傅里叶变换等，从而将激光器出射的原始光束整形为满足工艺要求及量产要求的光斑，使之充分满足集成电路先进制程等工艺对聚焦光斑尺寸（ $\mu\text{m}$  至  $\text{cm}$  级别）、形状（方形并尺寸可调、圆形、线形、一维二维三维子光束阵列、贝塞尔、涡旋等）、顶部平滑度（ $<1\%$ ）、边缘陡直度（ $>99\%$ ）、焦深（最大焦深  $\text{mm}$  级别）、有效焦距以及稳定可靠量产的要求。为满足部分工艺要求，公司具备多路激光器联合控制的工艺能力，以实现更精确的温差、加热深度控制，目前公司最高可以精确控制 4 路激光器以满足集成电路先进制程工艺需求。公司在光路整形方面有 20 余年积累，从光路设计到元件加工到组装调试到测试优化的全技术链条均自主掌控。

### （3）高精度能量密度控制技术

能量密度是半导体领域精密激光加工极为重要的工艺参数，直接影响工艺效果及生产良率。在多波长光路整形技术的基础上，公司通过空间约束、边缘锐利技术对聚焦光斑内的能量密度均匀性进行进一步提升，将光斑内的能量密度均匀

性提升至>99%的水平，而后配合偏振调控技术、光束指向稳定技术、能量密度实时原位监测及调控技术等，最终实现对能量密度的高精度及高稳定性控制，精度达到 5%量级，为工艺结果的片内均匀性、片间批间重复性以及多型号产品的稳定量产奠定技术基础。

#### **（4）复杂多变量协同监测检测技术**

为了满足半导体领域精密激光加工及稳定可靠量产的要求，公司采用了多种监测及检测技术，空间时间上分为原位实时监测检测、按需监测检测、必须监测检测三大类，通过集成多种传感器、信号处理放大滤波电路、通讯接口电路等实现了运行软件对设备关键运行参数（包括激光器功率及其稳定性、激光光轴中心稳定性、光斑形状尺寸及能量分布稳定性、焦点稳定性、位移系统稳定性、光学系统稳定性、传送装置稳定性、晶圆完整性等关键参数）的准确、完整、快速、高效监测检测以及数据处理分析，并结合良好的光学、机械预先设计提供一定容错空间，克服设备长期运行过程中由于光学等元件损耗导致的精度下滑，从而保证设备工作的长期稳定可靠。目前，公司设备长期运行精度可以维持于纳米级别，激光脉宽可以卡控于纳秒级别。

#### **（5）半导体领域多用途激光加工技术**

半导体领域激光精密加工技术按照激光与材料的作用效果可分为激光调材、激光增材、激光减材等三大类型。针对客户的具体需求及其归属工艺类型的自身特点，公司从激光器、光学系统、位移系统、激光轨迹控制系统、工艺气氛及压强控制系统等方面开展工作，结合公司多年在半导体领域激光精密加工技术方面的积累，研发出满足客户工艺要求的原型机，并在原型机上开展工艺及测试表征，根据测试表征结果与客户沟通反馈进行优化，最终开发成功面向某国产先进架构 3D NAND Flash 存储芯片创新工艺区域的非晶硅激光诱导结晶技术、面向 DRAM 存储芯片的非晶硅激光诱导外延生长技术并用于量产（国内首次），开发成功面向背照式图像传感器的超浅结杂质激光激活技术并用于量产（国内首次，激活后杂质峰值扩散深度<10nm），开发成功硅基功率器件背面杂质激光激活技术并用于我国高铁芯片量产，开发成功碳化硅欧姆接触激光退火技术并用于量产，开发成功超薄硅化物激光退火技术、非晶硅薄膜连续激光结晶技术等多项工艺技术。

### **(6) 半导体领域激光精密加工设备整机设计技术**

在上述技术的基础上，公司基于在激光设备领域 20 余年的深厚积累，从材料、元器件、模块、整机、备件等方面着手，集成光学整形技术、机械结构设计技术、电气控制技术、软件算法技术等进行设备的整机设计，同时设计上充分考虑半导体产业对设备量产稳定性、可靠性、设备间匹配性以及售后服务维修响应速度及效果的要求，采取有针对性的设计，对设计结果进行充分的验证后用于设备整机。

### **3、研发水平**

报告期内，公司研发投入分别为 1,528.13 万元、2,395.18 万元、5,873.72 万元、1,049.63 万元，研发投入占营业收入比例分别为 20.61%、12.56%、20.90%、28.66%。

公司在半导体等应用领域具备成熟的激光工艺和技术设备研发能力，以及丰富的前后道工艺整合经验。公司在激光工艺设备领域持续突破，除对标国际厂商先进产品连续推出多款国产解决方案外，还基于正向研发路径为国内领先半导体制造厂商的独家工艺成功开发了创新性激光工艺设备。目前，公司以低热预算、高空间精度且时域可调的热处理工艺能力，和高精度、低热应力激光微纳加工工艺能力，赋能下游半导体制造等行业，既面向高端工艺需求，也同步满足产业竞争环境下的性价比需求。

公司核心技术全流程覆盖光、机、电、算各个环节，并涵盖下游制造工艺领域。公司产品和技术自主研发水平较高，具有自主定义激光器、光路整形系统、精密位移控制系统、自动化控制系统等激光设备核心模块的能力，在核心关键技术上拥有自主知识产权，可以较快迭代速度有力支持国家半导体等产业发展。具体而言，公司的技术水平及特点说明如下：

#### **(1) 光学**

公司具备复杂光学系统搭建和全局优化能力，进而形成了各类激光光束整形及光学变换处理能力，可以精准调控光斑能量分布类型（高斯分布、一维平顶、二维平顶等）、边缘陡直度（陡直、光滑或边缘尺寸可调）、光斑形状（圆形、正方形、长方形、线形等）、光斑空间分布（一维分布、二维分布、三维分布）、光

斑尺寸（最小可突破瑞利极限、最大尺寸可达数十 mm）。

为适配半导体、精密电子制造等不同应用场景的制造要求，激光波长、脉宽、重复频率、功率/能量、光束质量等多个参数均需与具体工艺紧密结合；同时，不同类型的激光器控制方式、运行条件、工作寿命等特点也直接决定着整机设备的性能、可靠性和运维成本，公司已掌握多项半导体行业专用激光器的应用技术。

考虑到半导体等应用领域的严苛工艺量产要求，公司不仅可以结合工艺特征自主定义激光器关键指标参数并基于光学系统高效利用激光能量，而且具备在设备长期运转过程保障激光器、光学系统高度可靠、稳定的监控检测技术能力和工程化技术能力。

## （2）机械

机械结构包括承载功能用机械结构、固定功能用机械结构、运动系统用机械结构、调节用机械结构。基于良好设计建模能力并且在多轮迭代过程中持续优化，公司激光工艺设备采用的各类机械结构实现了高可靠性、高稳定性、高精度、高易用性和高可维护性。

同时考虑到半导体等行业激光工艺设备的特点，公司面向激光损伤、光轴稳定、温度漂移等方面挑战开展针对性的机械结构优化设计，以保障光学、运动和调节等其他系统的可靠性。

## （3）电气

除个别工艺使用与晶圆尺寸相当的激光光斑并一次覆盖整个晶圆完成工艺外，绝大多数工艺条件下激光光斑尺寸远小于晶圆尺寸，需要快速精确控制光斑位置、速度和能量，公司具备精确控制光斑与晶圆之间的相对位移及其位移轨迹，精准调节相对位移过程中的激光光束焦点位置，稳定维持光斑之间重叠的集成电气控制能力，从而保证晶圆能完整、平稳地接受激光光斑照射。

目前，公司在保障产能的基础上最高可以将激光光斑与晶圆特定加工区域间相对位置偏差控制在微米级别，并借助运动控制系统与激光器之间的时序兼容实现步进式激光加工工艺功能。

#### （4）软件算法

激光工艺设备的相关硬件包括激光器、执行器、传感器、位移平台、探测器、控制器等多种硬件类型，相关硬件的启动、运行、状态监测、调控、终止、联动等均通过软件系统实现。

公司在长期研发、迭代、测试、优化过程中积累了丰富的算法库，且进行完整的验证流程，目前公司基于自主研发的软件算法系统实现了设备软硬件的高度协调和设备整体的高度智能化运行。

#### （5）工艺研发

设备研发、制造的最终目的是实现半导体等领域客户所需的工艺效果并用于稳定量产，因此行业内有“设备研发，工艺先行”的经验特征，设备研发必须基于充分的工艺数据支持，工艺研发能力也是半导体工艺设备企业的关键能力之一。

公司技术团队在工艺研发领域具有二十多年积累，获得客户的广泛信任与支持，与客户合作成功开发了 BSI-CCD 图像芯片背面离子注入激光工艺技术、硅基 IGBT 功率芯片背面激光激活技术、SiC 功率芯片欧姆接触激光退火技术、某国产先进架构 3D NAND Flash 存储芯片创新工艺区域用非晶硅激光诱导结晶技术、DRAM 存储芯片 BLC&SNC 用非晶硅激光诱导外延生长技术、逻辑芯片前道超浅结激光退火技术、逻辑芯片前道动态表面合金激光退火技术、薄晶圆厚背金样片激光半切技术等多项工艺技术并均已用于设备量产。相关工艺的成功研发又进一步强化公司技术水平并巩固客户基础。

在成功研发并推出单步激光工艺基础上，公司以自身较强的技术能力、协调能力、服务意识以及与客户互信为基础，成功配合下游客户将单步工艺嵌入到工艺制程中并完成优化、整合，最终达到量产的目的。

#### （三）发行人报告期的主要财务数据和财务指标

公司主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.3.31/<br>2025 年 1-3 月 | 2024.12.31/<br>2024 年度 | 2023.12.31/<br>2023 年度 | 2022.12.31/<br>2022 年度 |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| 项目                                | 2025.3.31/<br>2025 年 1-3 月 | 2024.12.31/<br>2024 年度 | 2023.12.31/<br>2023 年度 | 2022.12.31/<br>2022 年度 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额（万元）                          | 104,852.46                 | 102,640.75             | 66,609.12              | 24,608.15              |
| 归属于母公司所有者<br>权益（万元）               | 53,436.50                  | 53,269.51              | 47,357.08              | 6,182.38               |
| 资产负债率（母公司）                        | 48.39%                     | 47.51%                 | 28.51%                 | 74.04%                 |
| 营业收入（万元）                          | 3,662.77                   | 28,102.42              | 19,075.73              | 7,414.56               |
| 净利润（万元）                           | 68.32                      | 5,491.16               | 2,279.87               | -938.22                |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润（万元）             | 79.96                      | 5,564.28               | 2,303.67               | -879.62                |
| 扣除非经常损益后归<br>属于母公司所有者的<br>净利润（万元） | -53.32                     | 4,834.56               | 2,177.26               | -920.00                |
| 基本每股收益（元）                         | 0.02                       | 1.15                   | 0.63                   | -0.33                  |
| 稀释每股收益（元）                         | 0.02                       | 1.15                   | 0.63                   | -0.33                  |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 0.15%                      | 11.06%                 | 9.98%                  | -43.35%                |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（万元）             | -2,716.99                  | 3,202.59               | -3,272.37              | -2,827.26              |
| 现金分红（万元）                          | -                          | -                      | -                      | -                      |
| 研发投入占营业收入<br>的比例                  | 28.66%                     | 20.90%                 | 12.56%                 | 20.61%                 |

#### （四）发行人存在的主要风险

##### 1、客户集中度较高的风险

报告期各期，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 66.86%、65.89%、83.45%和 97.67%，其中向客户 A 及其同一控制下的其他主体销售金额占当期营业收入的比例分别为 18.86%、42.87%、67.86%和 81.74%。公司的客户及产品结构日趋多元化，但仍存在对客户 A 及其同一控制下的其他主体收入占比较高，客户集中度较高的情况。

公司下游的晶圆制造产业兼具资本密集与技术密集特征，行业集中度较高，而公司激光热处理设备产品主要面向集成电路先进制程、三维异构集成等前沿高端应用领域，相关产能进一步集中于少数晶圆厂。且相较于国际设备厂商，公司业务规模相对较小，受制于融资渠道有限、资金实力不足、产能有限等因素，公司现阶段重点拓展并满足具有明确扩产预期的客户，导致公司业务呈现集中于国内主流、头部半导体制造商的阶段特征。若公司主要客户因自身技术更新、产业政策变化、市场竞争加剧等原因，导致其资本性支出下降，进而导致客户需求

订单量下降，则公司业绩稳定性也会受到较大影响。此外，如果公司后续不能持续开拓新客户并转化为收入，将不利于公司未来持续稳定发展。

## 2、经营业绩波动的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 3,662.77 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 -920.00 万元、2,177.26 万元、4,834.56 万元和 -53.32 万元。

半导体设备行业受下游市场需求波动的影响较大，如果未来市场竞争加剧、宏观经济景气度回落或者国家产业政策发生变化，下游客户对相关设备的需求量可能下降。此外，公司将保持对新产品和新技术的高研发投入，相关研发投入短期内将对公司经营业绩造成一定的影响。在以上因素影响下，不排除未来公司经营业绩出现波动甚至亏损的风险。

## 3、技术迭代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，涉及机械、化学、电子、信息、材料和能源等多学科尖端技术的融合应用，具有较高的技术门槛，技术更新迭代较快。为满足下游客户高速迭代的工艺需求，半导体设备需要保持同步升级。若公司产品及技术研发升级节奏无法满足下游客户需求，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

## 4、市场竞争风险

公司经过多年发展，已在半导体先进激光工艺设备领域建立起了一定的竞争优势，但不排除未来出现更多竞争对手进入该领域。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格及服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等会受到不利影响。

## 5、发行人实际控制人存在大额对外担保的风险

截至本上市保荐书签署日，发行人实际控制人叶向明、毛冬对东莞东骏电器有限公司（以下简称“东骏电器”）、东莞市汉邦能源有限公司（以下简称“汉邦能源”）等其控制企业以外的第三方提供的担保债务本金余额为 7.41 亿元，其中东骏电器担保债务本金余额 5.57 亿元、汉邦能源担保债务本金余额 1.84 亿元。

就上述叶向明、毛冬为东骏电器提供担保的债务，东骏电器贷款资金专项用于建设东骏广场项目。东骏广场项目为位于广东省东莞市南城街道的商业、办公楼，其 1 号楼已取得《现售备案证书》（莞商房现证第 202400211 号）、2 号楼已取得《预售许可证》（东莞商房预证字第 202300102 号）。农业银行于 2025 年 9 月 17 日发布《中国农业银行股份有限公司东莞分行业务经营用房购置项目招标公告》，根据上述公告，农业银行拟采购业务经营用房，要求房产位于东莞市主城区，用途为办公、商业，建筑面积约 2.40-2.60 万平方米，报名截止日期为 2025 年 9 月 21 日。根据东骏电器说明，东骏广场项目房产各项指标均符合农业银行的采购要求并已完成报名；如果东骏电器成为农业银行上述业务经营用房购置项目选定的供应商，相关交易完成后，东骏电器将使用房产销售款偿还相关债务，发行人实际控制人担保责任将相应消减。

除公司股权外，发行人实际控制人叶向明、毛冬的其他资产主要包括两人通过东骏投资持有的东骏激光 63.44% 股权以及其他一级市场投资、房产、个人理财等。就叶向明、毛冬提供担保事项，两人承诺：“截至 2025 年 9 月 26 日，本人及本人的关联方未收到主债权人提出的任何要求承担担保责任的主张，无论该等主张是书面或其他形式。如因主债务人迟延履行主债务或其他违约事项导致主债权人主张本人对担保债务承担连带保证责任，本人将立即针对相关事项采取包括但不限于转让除东骏投资、莱普科技股权之外的其他资产（含东骏投资持有的东骏激光股权）等积极措施，并使用其他资产或其他自筹资金偿还担保债务，以避免相关违约事项对莱普科技造成不利影响，确保莱普科技的控制权稳定性”。

虽然发行人实际控制人叶向明、毛冬已作出上述承诺，但鉴于相关担保的主债务本金余额较大，如果担保债务逾期未偿还，主债权人主张叶向明、毛冬承担连带保证责任，而两人未能及时清偿担保债务，则存在两人持有的发行人控股股东东骏投资的股权被主债权人申请冻结、甚至被司法强制执行的风险。

二、发行人本次发行情况

| (一) 本次发行的基本情况 |                 |           |         |
|---------------|-----------------|-----------|---------|
| 股票种类          | 人民币普通股（A 股）     |           |         |
| 每股面值          | 人民币 1.00 元      |           |         |
| 发行股数          | 不超过 1,606.00 万股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |

|                                          |                                                                                                 |           |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 其中：发行新股数量                                | 不超过 1,606.00 万股                                                                                 | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量                               | 无                                                                                               | 占发行后总股本比例 | 无       |
| 发行后总股本                                   | 不超过 6,424.00 万股                                                                                 |           |         |
| 每股发行价格                                   | 【】元                                                                                             |           |         |
| 发行市盈率                                    | 【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）                                                                           |           |         |
| 发行前每股净资产                                 | 【】元                                                                                             | 发行前每股收益   | 【】元     |
| 发行后每股净资产                                 | 【】元                                                                                             | 发行后每股收益   | 【】元     |
| 发行市净率                                    | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）                                                                          |           |         |
| 预测净利润（如有）                                | 无                                                                                               |           |         |
| 发行方式                                     | 本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式                                                |           |         |
| 发行对象                                     | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开通科创板交易权限的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）                                   |           |         |
| 承销方式                                     | 余额包销                                                                                            |           |         |
| 募集资金总额                                   | 【】万元                                                                                            |           |         |
| 募集资金净额                                   | 【】万元                                                                                            |           |         |
| 募集资金投资项目                                 | 晶圆制造设备开发与制造中心项目                                                                                 |           |         |
|                                          | 先进封装设备开发与制造中心项目                                                                                 |           |         |
|                                          | 研发中心及信息化建设项目                                                                                    |           |         |
|                                          | 研发、技术支持与营销网络建设项目                                                                                |           |         |
|                                          | 补充流动资金                                                                                          |           |         |
| 发行费用概算                                   | 本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括保荐及承销费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；用于本次发行的信息披露费用【】万元；发行手续费及其他【】万元                |           |         |
| 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况                       | 若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行的新股，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露                      |           |         |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况                        | 保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件 |           |         |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有） | 不适用                                                                                             |           |         |
| （二）本次发行上市的重要日期                           |                                                                                                 |           |         |
| 刊登发行公告日期                                 |                                                                                                 | 【】年【】月【】日 |         |
| 开始询价推介时间                                 |                                                                                                 | 【】年【】月【】日 |         |
| 刊登定价公告日期                                 |                                                                                                 | 【】年【】月【】日 |         |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期    | 【】年【】月【】日 |

### 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

#### （一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定王志伟、陈忱担任本次成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王志伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：南京国博电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、中铝国际工程股份有限公司首次公开发行并在主板上市项目、创意信息技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、西部证券股份有限公司首次公开发行并在中小板上市项目、辽宁成大股份有限公司非公开发行股票项目、江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票项目、创意信息技术股份有限公司发行股份购买资产项目等；目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。王志伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈忱女士：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目等；目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。陈忱女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### （二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为陈剑锋，其职业情况如下：

陈剑锋先生：保荐代表人，中国注册会计师，具有法律职业资格，硕士研究

生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等。陈剑锋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### **（三）本次证券发行项目组其他成员**

胡明勇先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行董事，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等。胡明勇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

赵在华先生：保荐代表人，中国注册会计师，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目等。赵在华先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

翟佳俊先生：保荐代表人，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。翟佳俊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘牧谦先生：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：南京国博电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、上海艾麒信息科技股份有限公司新三板挂牌项目、浙报数字文化集团股份有限公司重大资产重组项目等。刘牧谦先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

徐睿女士：硕士研究生学历，具有香港证券从业资格。现任中信建投证券投

资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、珠海博雅科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券项目、中科创达软件股份有限公司重大资产购买 Rightware Oy 项目、神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售项目、歌尔微电子股份有限公司香港主板上市项目（在审）等。徐睿女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

肖晨刚先生：保荐代表人，中国注册会计师，税务师，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、广东基烁新材料股份有限公司新三板挂牌项目、黑龙江交通发展股份有限公司豁免要约收购项目等。肖晨刚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李昊天先生：保荐代表人，博士学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目等。李昊天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

许正源先生：研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目。许正源先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄泽森先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。黄泽森先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

**（四）联系地址、电话和其他通讯方式**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 保荐人（主承销商）： | 中信建投证券股份有限公司                    |
| 联系地址：      | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 |
| 邮编：        | 100026                          |
| 联系电话：      | 010-65608358                    |
| 传真：        | 010-65608358                    |

**四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明**

（一）保荐人通过投资其他主体间接持有发行人股份，穿透后合计持股比例低于十万分之一。该等间接投资行为系相关间接层面投资主体所作出的独立投资决策，并非保荐人主动对发行人进行投资。除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

此外，保荐人将根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定，安排相关子公司参与本次发行战略配售。

（二）截至本上市保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方的任何股份的情形。

（三）截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，或在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

**五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项**

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面

临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

## **六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明**

### **（一）董事会的批准**

2025年8月8日，发行人召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》

等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

**（二）股东大会的批准**

2025 年 8 月 24 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东会决议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

**七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程**

**（一）发行人符合科创板行业领域的规定**

公司以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处的行业为“专用设备制造业（C35）”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的半导体器件专用设备制造为战略性新兴产业，被纳入战略性新兴产业“1 新一代信息技术产业-1.2 电子核心产业-1.2.1 新型电子元器件及设备制造-半导体器件专用设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（上证发 2024 年 4 月修订），公司属于“第五条（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”列示的科技创新企业。公司符合科创板关于行业领域的要求。

**（二）发行人符合科创属性要求的规定**

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条科创属性规定的 4 项指标，符合科创板定位，具体指标情况如下：

| 科创属性评价标准一      | 是否符合                                                             | 指标情况                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 最近三年研发投入占营业收入比 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2022 年至 2024 年，公司研发投入合计 |

| 科创属性评价标准一                                | 是否符合                                                             | 指标情况                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 例 5%以上, 或者最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上       |                                                                  | 9,797.04 万元, 占营业收入比例为 17.95%, 满足标准。                                                     |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日, 发行人研发人员 62 名, 研发人员占当年员工总数的比例为 22.38%, 超过 10%。                      |
| 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至本上市保荐书出具日, 公司已取得发明专利 15 项, 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项。                                |
| 最近三年营业收入复合增长率达到 25%, 或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2022 至 2024 年, 公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元和 28,102.42 万元, 年复合增长率 94.68%, 超过 25%。 |

公司符合国家科技创新战略、拥有关键核心技术等先进技术、科技创新能力突出、科技成果转化能力突出、行业地位突出、市场认可度较高。本保荐人根据  
公司情况与《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市  
申报及推荐暂行规定》等相关规定中关于科创板定位要求的逐条比对, 公司符合  
科创板定位要求。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的上市条件的说明

（一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

（1）公司自整体变更设立以来, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理  
准则》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和证监会的相关要求,  
结合公司实际情况逐步建立了由股东会、董事会、监事会/审计委员会和经营管  
理层组成的法人治理结构, 制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事  
会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》  
《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》等一系列  
公司治理制度, 明确了股东会、董事会、监事会/审计委员会、总经理及董事会  
秘书的权责范围和工作程序, 为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保  
证。

此外, 发行人董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会 4 个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了科学和规范的治理制度。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（2）根据致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年第一季度营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 和 3,662.77 万元，净利润分别为-938.22 万元、2,279.87 万元、5,491.16 万元和 68.32 万元。公司营业收入持续增长，并且实现盈利。

综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（3）根据致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》，发行人最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

综上所述，发行人最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（4）根据发行人及其控股股东、实际控制人的说明、发行人提供的资料并经保荐人的审慎核查，截至本上市保荐书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

综上所述，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（5）发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

## **2、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件**

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

(1) 经核查发行人工商档案、纳税资料、发起人协议等资料，发行人前身莱普有限成立于 2003 年 12 月 22 日。2021 年 8 月 11 日，莱普有限召开股东会作出决议，同意莱普有限整体变更为股份有限公司。莱普有限以截至 2021 年 6 月 30 日经审计的净资产 11,193,232.12 元为基础，折合为 10,000,000.00 股股份，每股面值 1.00 元，净资产超过股本部分计入资本公积；同日，莱普有限全体股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰和东莞天戈签订了发起人协议。2021 年 9 月 1 日，公司完成工商变更登记。

经核查发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列公司治理制度，发行人相关会议文件，组织机构安排等资料，并访谈发行人高级管理人员，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东会、董事会、监事会/审计委员会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，本保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

(2) 经核查发行人内部控制流程、内部控制制度、会计记录、记账凭证、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》、致同会计师出具《内部控制审计报告》等资料，并访谈发行人财务负责人，本保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年一期财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

(3) 经核查发行人业务经营情况、工商档案、主要资产权属证明文件、控股股东、实际控制人调查表、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》等资料，并访谈发行人高级管理人员，本保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交

易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

（4）经核查发行人报告期内主营业务收入构成、重大销售合同、主要客户资料等资料，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化；经核查发行人工商档案，聘请董事、高级管理人员的相关会议决议，核心技术人员的《劳动合同》，发行人最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，发行人核心技术人员稳定且最近两年内没有发生重大不利变化；经核查发行人工商档案，控股股东、实际控制人访谈文件等资料，最近两年发行人的实际控制人始终为叶向明、毛冬，未发生变更。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。本保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

（5）经核查发行人主要资产清单、主要资产权属证明文件、致同会计师出具的无保留意见的《审计报告》、发行人律师出具的《法律意见书》等资料，本保荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

（6）经核查发行人主营业务情况，相关主管机构出具的有关证明文件，并经公开信息查询，本保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

**（二）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定**

经核查，若本次拟公开发行的 1,606.00 万股股份全部发行完毕，发行人股本总额将达到人民币 6,424.00 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000.00 万元。

**（三）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定**

经核查，发行人拟公开发行不超过 1,606.00 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。

**（四）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准”规定**

发行人选择的上市标准为《上市规则》第 2.1.2 条第（一）款：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

根据发行人 2023 年 12 月外部融资的估值情况以及同行业可比上市公司的估值，预计发行人的市值不低于人民币 10 亿元；根据致同会计师出具的《审计报告》，发行人 2023 年及 2024 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,177.26 万元、4,834.56 万元，2024 年度营业收入为 28,102.42 万元，因此，发行人预计市值不低于 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5000 万元，且最近一年营业收入不低于人民币 1 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（一）款规定。

**（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定**

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

## 九、持续督导期间的工作安排

| 事项                                                  | 工作计划                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）持续督导事项</b>                                    |                                                                                                                |
| 1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。         | 根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。                                                                                 |
| 2、督导公司有效执行并完善防止董事、审计委员会成员以及高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度。 | 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助公司制定有关制度并督导其实施。                                                                  |
| 3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。           | 督导公司的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本保荐人将按照公平、独立的原则发表意见。公司因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。 |
| 4、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。       | 关注并审阅公司的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导公司履行信息披露义务。                                                                   |
| 5、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。                       | 定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席公司董事会、股东会，对公司募集资金投资项目的实施、变更发表意见。                                                            |
| 6、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见。                           | 督导公司遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。                                                                        |
| <b>（二）持续督导期限</b>                                    | 发行人首次公开发行股票并在科创板上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐人将继续完成。                                          |

## 十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次莱普科技发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为莱普科技本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名： 陈剑锋  
陈剑锋

保荐代表人签名： 王志伟      陈忱  
王志伟      陈忱

内核负责人签名： 张耀坤  
张耀坤

保荐业务负责人签名： 刘乃生  
刘乃生

法定代表人/董事长签名： 刘成  
刘成

